



2025年3月期中間期 決算説明

1. 当期連結決算においては、フェローテックHD単体は2024年4月～2024年9月末の業績を、それ以外の連結子会社・持分法適用会社は2024年1月～6月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、2025年3月期中間決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は開示日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

業績

- 2Q連結売上高は1,352億円、前同比+28%、営業利益は143億円、同+9.3%
- 半導体市況は回復基調、積極営業を推進、顧客需要捉え、売上増加を継続
- 自動化、製品開発、市場開拓を強化、センサ事業の成長を推進

半導体等関連

- 金属加工、石英、セラミックス、装置組立のマレーシア・クリム工場が稼働、米国顧客等の中国外生産(Ex-China)ニーズに対応、顧客認定が順調に進展、石川第三工場も2025年に稼働予定
- 中国常山のセラミックス新工場稼働開始、新製品の開発(ESC、SiSiC等)を推進

電子デバイス・ 車載

- パワー半導体基板は調整局面も中長期の成長継続を予想、ジョホール工場が2025年稼働開始
- サーモモジュールは生成AI向けが牽引し好調、マレーシア・ジョホール生産を計画
- センサは営業活動強化、自動化強化等の成長戦略を推進

株主還元等

- 中国上場の洗浄FTSVAが株式交換によりパワー半導体FLHを傘下に置く計画、当社保有の株式時価が増加見通し、資金調達が多様化の選択肢・活用方法を検討していく
- 中間配当を増配、自社株買いを実施、株主還元の強化・多様化を推進する

製品別売上高

(百万円)		2024/3期 2Q	2025/3期 2Q	前年同期比 (%)
半	導 体 等 装 置 関 連	60,257	84,042	39.5
	真空シール・金属加工	11,730	19,347	64.9
	石英製品	11,584	16,134	39.3
	シリコンパーツ	7,712	7,172	△7.0
	セラミックス	11,657	15,448	32.5
	CVD-SiC	2,999	3,992	33.1
	EBガン・LED蒸着装置	3,011	4,076	35.4
	ウエーハ加工(連結対象のみ)	43	11	△74.4
	再生ウエーハ	752	1,251	66.4
	装置部品洗浄	5,424	7,061	30.2
	石英坩堝	5,341	9,547	78.7
電	子 デ バ イ ス	18,834	23,085	22.6
	サーモジュール	8,844	12,431	40.6
	パワー半導体基板	7,245	8,692	20.0
	磁性流体・その他	398	575	44.5
	センサ	2,344	1,387	△40.8
車	載 関 連	14,006	14,304	2.1
	サーモジュール	1,795	3,108	73.1
	パワー半導体基板	8,857	9,628	8.7
	センサ	3,352	1,567	△53.3
そ	の 他	12,396	13,723	10.7
合	計	105,494	135,157	28.1

- 中国、常山に金属加工、石英、サーモモジュール、セラミックス、SiPの拠点を置き、自動化・効率化進展
- マレーシア・クリム、金属加工、石英、セラミックス、装置組立の工場が稼働開始・顧客認定も進捗、米国顧客等の中国外生産ニーズに対応。ジョホールのパワー半導体基板、サーモモジュール、SiP生産計画進む

中国・常山



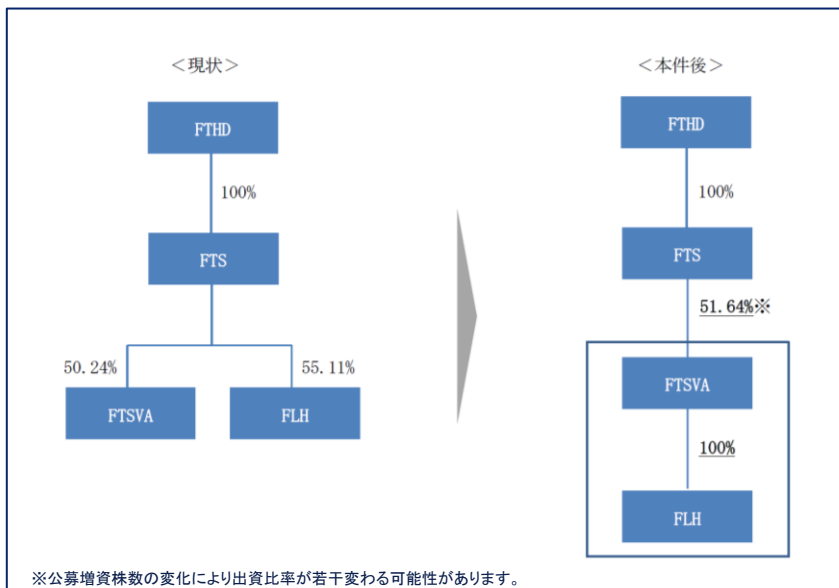
マレーシア・クリム



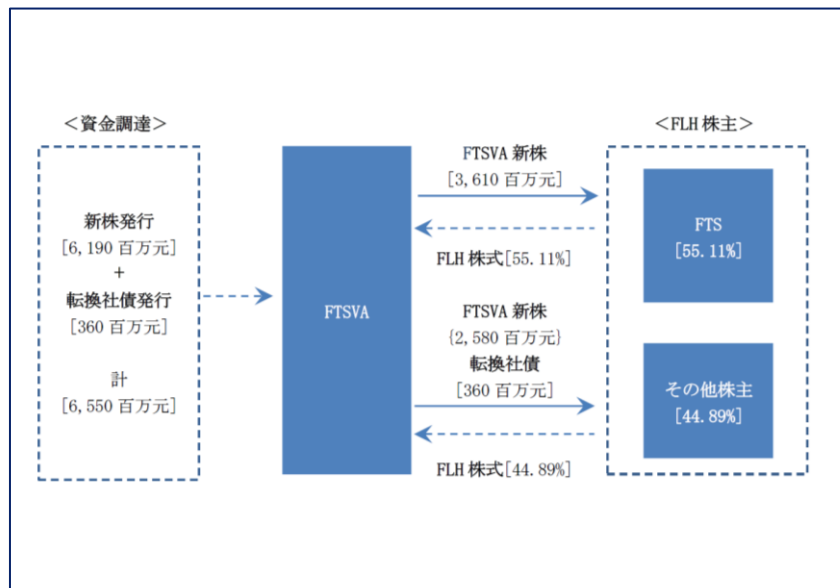
FTSVAによるFLH子会社化計画

- FTSVAが株式交換（FLH株式を購入、FLH株主に対しFTSVA株式及びFTSVA転換社債を発行し交付）しFLHを子会社化、併せて公募増資を実施する計画

資本構成図（下線部が変更となる箇所）



買収ストラクチャー



【凡例】 FTHD:フェローテックホールディングス(当社)、 FTS:上海申和投资有限公司、中国統括会社

FTSVA:安徽富樂德科技發展股份有限公司、部品洗浄事業子会社、深セン証券取引所創業板に上場中

FLH:江蘇富樂華半導體科技股份有限公司、パワー半導體基板事業子会社

- 1) 自己株式の取得及び2) 年間配当金の増加の、2つの株主還元策を発表
- 株主還元方針を見直し、「株主還元増加を重視、持続的な収益増強による配当の増加を目指しながら、自社株買いも機動的に活用、総還元性向30%を意識して、利益還元を図っていく」

自己株式の取得

取得上限額: **5**億円

*発行済み株式数に対し最大0.42%
期間: 2024/11/15~2025/3/31

増配(25/3期)

年間配当金: **100**円



年間配当金: **110**円

連結決算サマリー

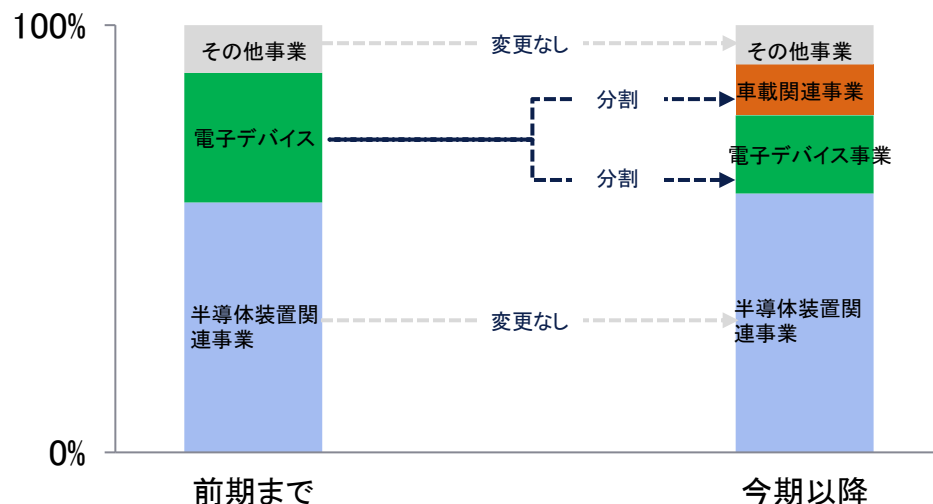
(百万円)	2024/3期 2Q	2025/3期 2Q	前年同期比		
	金額	金額	金額	増減率(%)	
売上高	105,494	135,157	29,662	28.1	売上高: 前同比+28.1% 売上総利益: 前同比+11.1% ・粗利率の低下は、新工場等の減価償却費の増加、 PV市場低迷による石英坩堝の収益性悪化等による
売上原価	71,182	97,046	25,863	36.3	
売上総利益	34,311	38,111	3,799	11.1	
販売管理費	21,276	23,859	2,583	12.1	販管費: 前同比+12.1%、試験研究費、労務費の増加等 営業利益: 前同比+9.3% 営業外収益: 前同比+15.2%、為替差益-9.8億円、補助金収入+15.6億円等 営業外費用: 前同比+68.4%、ウエーハ等の持分法投資損失+12.3億円 経常利益: 前同比+1.7%
営業利益	13,035	14,251	1,216	9.3	
営業外収益	4,621	5,324	702	15.2	
営業外費用	2,438	4,105	1,666	68.4	
経常利益	15,217	15,470	252	1.7	
特別利益	24	5	△ 19	△ 79.2	非支配持分利益: 22.3億円 ・パワー半導体基板: 11.0億円 ・シリコンパーツ・坩堝: 6.3億円 ・洗浄: 5.4億円 ・再生ウエーハ: △ 2.5億円 当期純利益: 前同比+9.5%
特別損失	495	-	△ 495	-	
非支配株主に帰属する当期純損益	2,923	2,228	△ 695	△ 23.8	
親会社株主に帰属する当期純利益	8,390	9,190	799	9.5	
設備投資額*	33,423	22,882	△ 10,540	△ 31.5	
減価償却費	7,913	11,241	3,328	42.1	
為替レート(期中平均)	米ドル: 136.54円 中国元: 19.55円	米ドル: 154.06円 中国元: 21.25円	-	-	

*設備投資額＝有形固定資産、無形固定資産の取得額の合計

セグメント変更に伴う過年度の遡及修正について

- 今期からの車載関連事業セグメント追加に伴い、前期の一部セグメント数値を遡及修正
- 製品用途を軸に、従来の電子デバイスセグメント事業の数値を、電子デバイス事業と車載関連事業に分割

前期数値の遡及修正に伴う売上高のイメージ



【詳細】

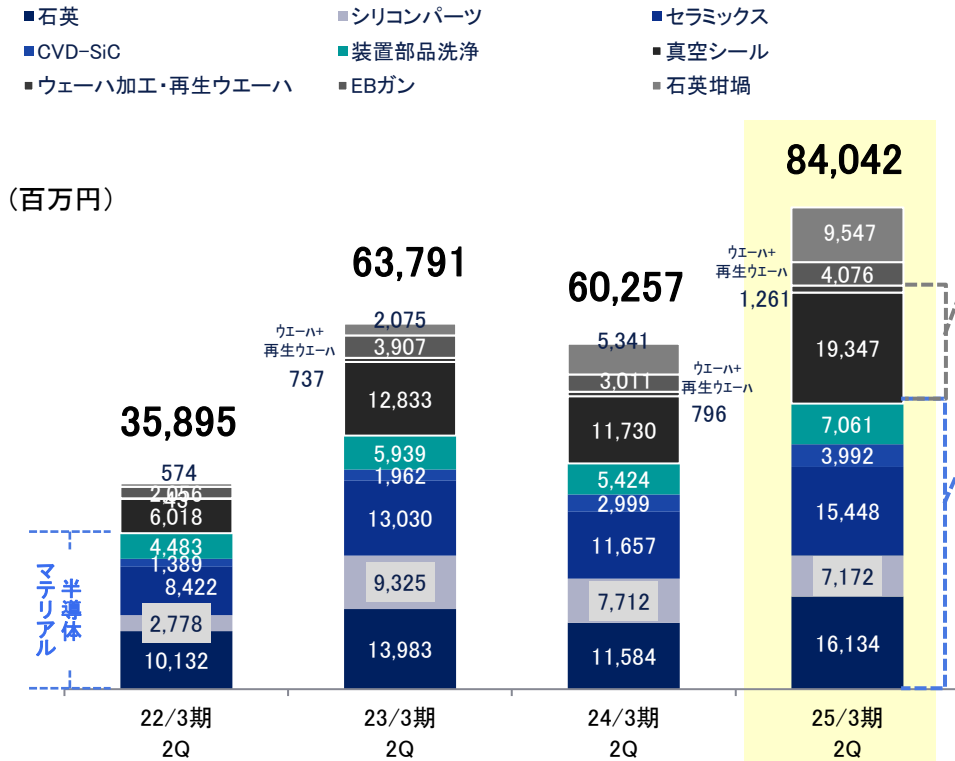
- 今期より車載関連セグメントを新設
 - 車載関連セグメントは従来の電子デバイス事業に含まれていた「サーモモジュール」、「パワー半導体基板」、「センサ」のうち、用途が車載関連となるものを計上
 - 今期以降、従来の電子デバイス事業の数値は車載関連と電子デバイス事業に分割されることとなるため、当資料では比較基準を統一するため、前期資料を遡及修正
 - 修正に伴い、前期の電子デバイス事業の数値は大きく変動しております
- *遡及修正は前期のみであり、23/3期以前は修正を行っておりません

セグメント別売上高および営業利益

売上高 (単位:百万円)	2024/3期 2Q		2025/3期 2Q		前年同期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	60,257	57.1	84,042	62.2	23,785	39.5
電 子 デ バ イ ス	18,834	17.9	23,085	17.1	4,251	22.6
車 載 関 連	14,006	13.3	14,304	10.6	298	2.1
そ の 他	12,396	11.8	13,723	10.2	1,327	10.7
合 計	105,494	100.0	135,157	100.0	29,662	28.1

営業利益 (単位:百万円)	2024/3期 2Q		2025/3期 2Q		前年同期比	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	7,788	12.9	8,363	10.0	574	7.4
電 子 デ バ イ ス	3,335	17.7	3,992	17.3	656	19.7
車 載 関 連	2,745	19.6	1,323	9.2	△ 1,421	△ 51.8
そ の 他	△179	－	793	5.8	972	－
調 整 額	△654	－	△220	－	434	－
合 計	13,035	12.4	14,251	10.5	1,216	9.3

売上高の推移



セグメント総括

- 半導体市況は回復傾向から、半導体等装置関連の売上は増加、特に金属加工が大幅増。石英坩堝はPV向け市況悪化見通し

真空シール・金属加工、ウェーハ加工・再生ウェーハ

- 真空シール・金属加工が、前同比+80%、+68億円の大幅増加
製造装置メーカーからの受注急増

半導体材料、洗浄事業等

【半導体材料（石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC）】

- 石英: 前同比+39%、機械加工品の回復が貢献
- シリコンパーツ: 前同比△7%、顧客在庫の影響等あり低迷
- セラミックス: 前同比+33%、装置メーカーからの受注回復、常山新工場稼働開始

- CVD-SiC: 前同比+33%、岡山工場増強が貢献

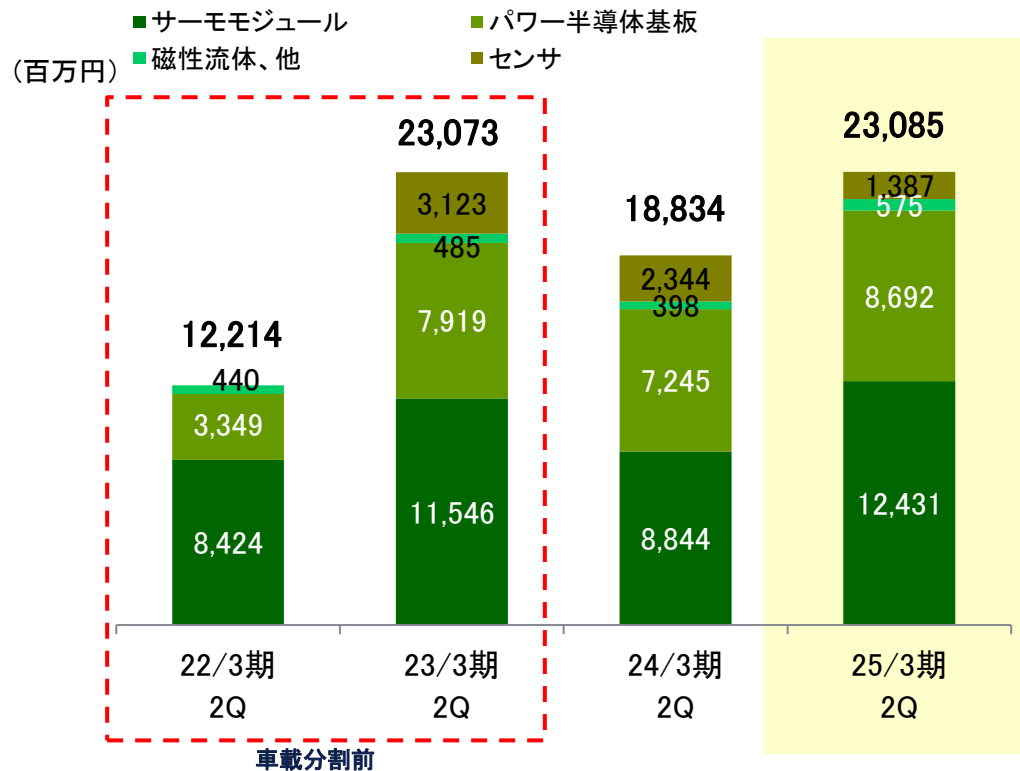
【洗浄】

- 前同比+30%、半導体生産の回復により増加

【石英坩堝】

- 前同比+79%、上期はPVメーカー向け売上が増加も収益性は低下、下期は減少見通し

売上高の推移



セグメント総括

- ・ サーモモジュールの売上伸長、パワー半導体は前同比は増加
- ・ センサは大泉製作所の決算期変更により24.3上期は4-6月の3か月間の反映にて減少

製品別

【サーモモジュール】

- ・ 前同比+41%、生成AI関連需要伸長が貢献

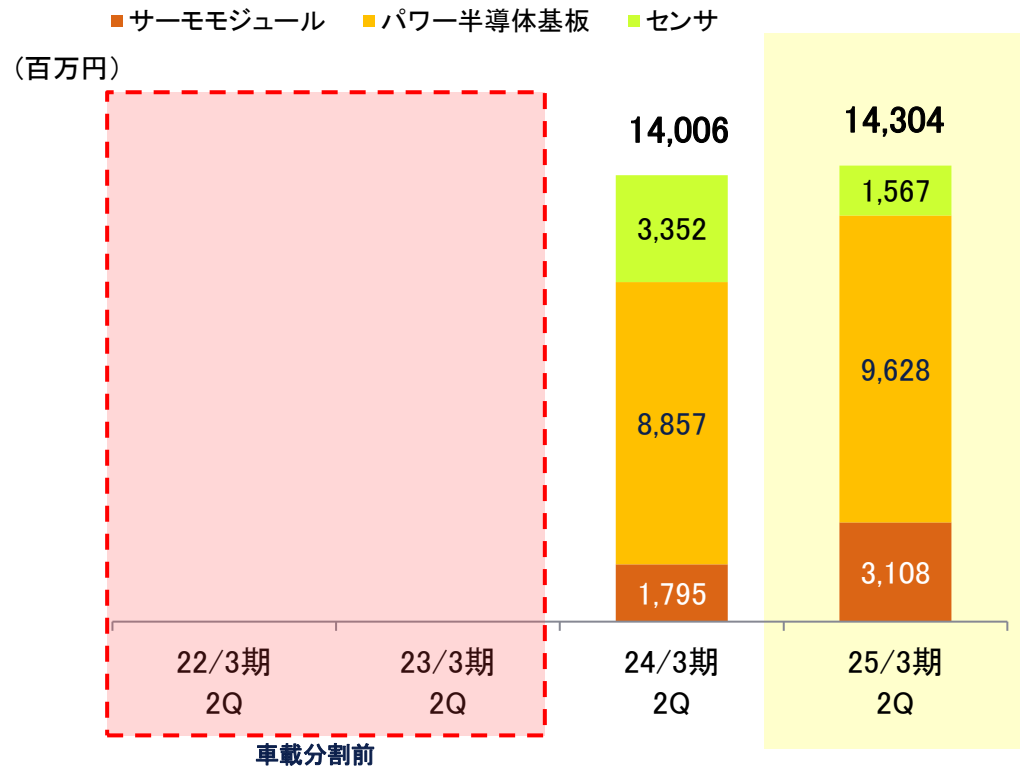
【パワー半導体基板】

- ・ 24/3上期比増も24/3期下期比では減少、顧客在庫要因等、調整局面
中長期的な顧客需要は成長見通し

【センサー】

- ・ 決算期変更により25/3上期は3か月間の実績
営業活動強化、今後の成長を期待

売上高の推移



セグメント総括

- ・ センサは決算期変更のため減少も、パワー半導体基板及びサーマモジュールは売上増加、セグメント売上はほぼ前同並

製品別

【サーマモジュール】

- ・ 中国自動車向け需要開拓、前同比+73%

【パワー半導体基板】

- ・ 自動車向けAMB基板の増加により、前同比+9%

【センサー】

- ・ 大泉製作所決算期変更の影響から減少

連結貸借対照表 ～資産～

(百万円)		2024/3期 期末	2025/3期 9月末	増減額
流	動 資 産	248,408	289,842	41,434
	現金及び預金	117,254	120,196	2,941
	受取手形及び売掛金	61,940	89,046	27,105
	たな卸資産	56,909	68,459	11,549
固	定 資 産	261,618	302,947	41,329
	有形固定資産	201,339	239,137	37,797
	建物及び構築物(純額)	66,583	91,954	25,371
	機械装置及び運搬具(純額)	59,533	81,701	22,167
	工具、器具及び備品(純額)	7,468	8,757	1,289
	土地	4,660	4,672	12
	リース資産(純額)	12,018	14,796	2,777
	建設仮勘定	51,075	37,254	△ 13,820
	無形固定資産	6,611	7,016	404
	のれん	2,010	1,954	△ 56
	投資その他資産	53,666	56,794	3,127
資	産 合 計	510,026	592,790	82,763

【流動資産の主な増加要因等】

- ・現預金+29億円(IPO済・予定先の現預金増による)
- ・売上債権及び在庫の増加は、売上増加による

【有形固定資産の主な増加要因等】

- ・マレーシア投資等により有形固定資産+378億円
(マレーシアFTMM+71億円、マレーシアFLHM+51億円、センサ麗水+27億円、セラミックス常山+27億円、日本FTMT+27億円等)

【投資その他資産の主な増加要因等】

- ・関係会社株式、投資有価証券等増加

連結貸借対照表 ～負債及び純資産～

(百万円)		2024/3期 期末	2025/3期 9月末	増減額
流	動 負 債	122,148	142,651	20,502
	支払手形、買掛金及び電子記録債務	42,302	53,730	11,428
	短期借入金	26,454	32,626	6,172
	1年内返済長期借入金 +1年内償還社債	21,022	17,902	△ 3,119
固	定 負 債	109,712	125,558	15,846
	社債	320	—	△ 320
	転換社債型新株予約権付社債	25,000	25,000	—
	長期借入金	62,364	76,462	14,098
負	債 合 計	231,860	268,209	36,349
純	資 産	278,166	324,580	46,414
	株主資本	177,638	184,712	7,074
	その他の包括利益累計額	26,771	53,190	26,419
	非支配株主持分	73,756	86,677	12,920
負 債 ・ 純 資 産 合 計		510,026	592,790	82,763
自 己 資 本 比 率		40.1%	40.1%	0pt
為 替 レ ー ト (期 末 日)	米ドル: 141.83円 中国元: 19.93円	米ドル: 161.07円 中国元: 22.04円	—	—

【流動負債、固定負債の主な変動要因等】

短期借入+1年内長借・社債	+30億円
長期借入金	+138億円
有利子負債合計	+168億円

【純資産の主な変動要因等】

株主資本+70億円

その他の包括利益累計額+264億円
(内、為替換算調整勘定+272億円)

非支配株主持分+129億円
(パワー半導体+39億円、シリコンパーツ・坩堝
+23億円、洗浄+18億円)

【自己資本比率】

自己資本比率40.1%、純資産比率 54.8%

キャッシュフロー計算書

(百万円)	2024/3期 2Q	2025/3期 2Q
営業活動によるキャッシュフロー	6,789	4,151
税金等調整前四半期純利益	14,747	15,475
減価償却費	7,913	11,241
為替差損益(△:益)	△ 609	△ 417
売上債権の増減(△:増加)	△ 830	△ 17,544
たな卸資産の増減(△:増加)	△ 5,271	△ 5,963
仕入債務の増減(△:減少)	△ 7,532	4,400
持分法による投資損益(△:益)	1,324	2,560
その他	△ 2,952	△ 5,601
投資活動によるキャッシュフロー	△ 29,101	△ 17,736
有形固定資産取得による支出	△ 33,235	△ 22,781
無形固定資産の取得による支出	△ 187	△ 101
投資有価証券の取得による支出	△ 2,000	△ 1,107
その他	6,322	6,253
財務活動によるキャッシュフロー	41,659	12,169
短期借入金の増減額	2,177	4,192
長期借入れによる収入	28,322	20,031
長期借入金の返済による支出	△ 7,328	△ 8,888
社債の償還による支出	△ 3,724	△ 3,423
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	24,898	-
非支配株主からの払込みによる収入	-	2,997
その他	△ 2,685	△ 2,740
現金及び現金同等物の増加額	23,761	7,562
現金及び現金同等物の期首残高	95,905	96,806
現金及び現金同等物の期末残高	119,666	104,368

【営業CFの状況】

減価償却費: 112億円、前同比+33億円

運転資本の増減: △ 191億円

【投資CFの状況】

有形固定資産の取得: △ 228億円

その他: +63億円(定期預金純増+63億円)

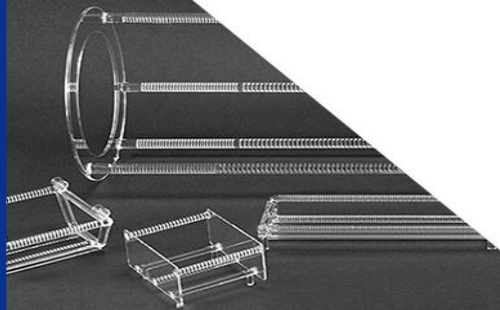
【財務CFの状況】

長期借入による収入: 200億円、FTHD等で借入

非支配株主払込: +30億円、麗水センサ30億円



2025年3月期 通期業績予想



25/3期 通期業績予想

- 半導体マーケットの回復基調による半導体等装置関連の売上増加、パワー半導体基板の売上増により売上予想を上方修正。利益は、太陽光パネル向け石英坩堝等の採算悪化、新工場立上げコスト増、パワー半導体基板の競争激化等の要因に鑑みて据置

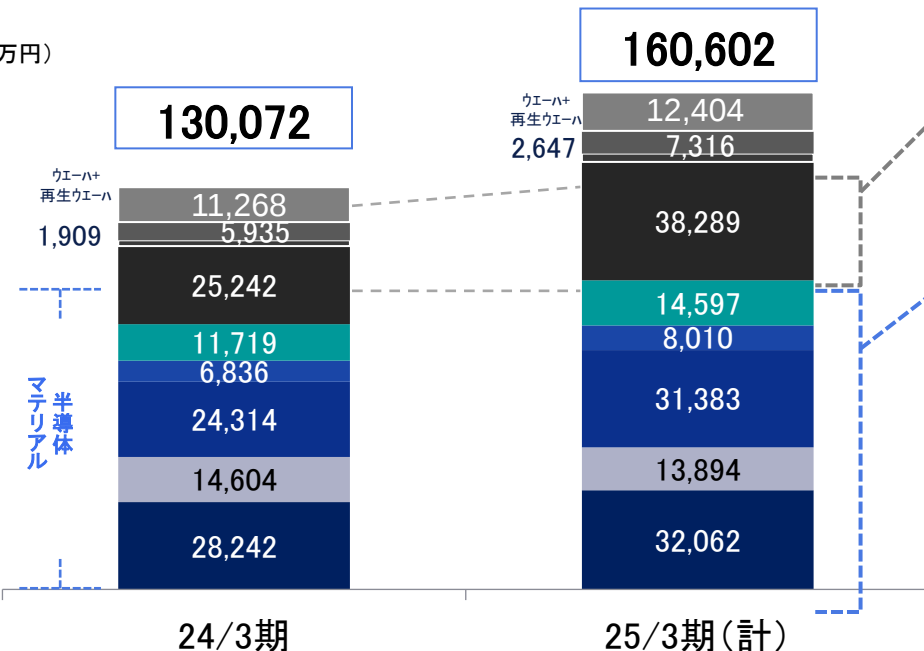
(百万円)	2024/3期	2025/3期		期初予想対 修正予想比	前期比
	実績	期初予想	修正予想		
売上高	222,430	235,000	265,000	12.8%	19.1%
営業利益	24,872	26,000	26,000	0.0%	4.5%
経常利益	26,537	26,000	26,000	0.0%	△ 2.0%
親会社に帰属する 当期純利益	15,154	16,000	16,000	0.0%	5.6%
減価償却費	16,398	20,000	24,000	20.0%	46.4%
EBITDA	41,270	46,000	50,000	8.7%	21.2%
設備投資額*	75,227	60,000	60,000	0.0%	△ 20.2%
想定為替レート(期中平均)	米ドル: 141.20円 中国元: 19.87円	米ドル: 150円 中国元: 21円	米ドル: 152円 中国元: 21円	-	-

*設備投資額＝有形資産、無形固定資産の取得額の合計

売上高の推移

- 石英
- シリコンパーツ
- セラミックス
- CVD-SiC
- 装置部品洗浄
- 真空シール・金属加工
- ウェーハ加工+再生ウェーハ
- EBガン
- 石英坩堝

(百万円)



セグメント総括

- ・ 半導体市況は回復傾向、需要を積極的に取込み、売上増加
- ・ 特に金属加工の売上が増加、半導体材料は製品毎と濃淡
- ・ 石英坩堝はPV向けが急減速

真空シール・金属加工

- ・ 前期比+60%、半導体製造装置メーカーの需要堅調、常山工場が牽引、マレーシア工場の立上げ順調

半導体材料、洗浄事業

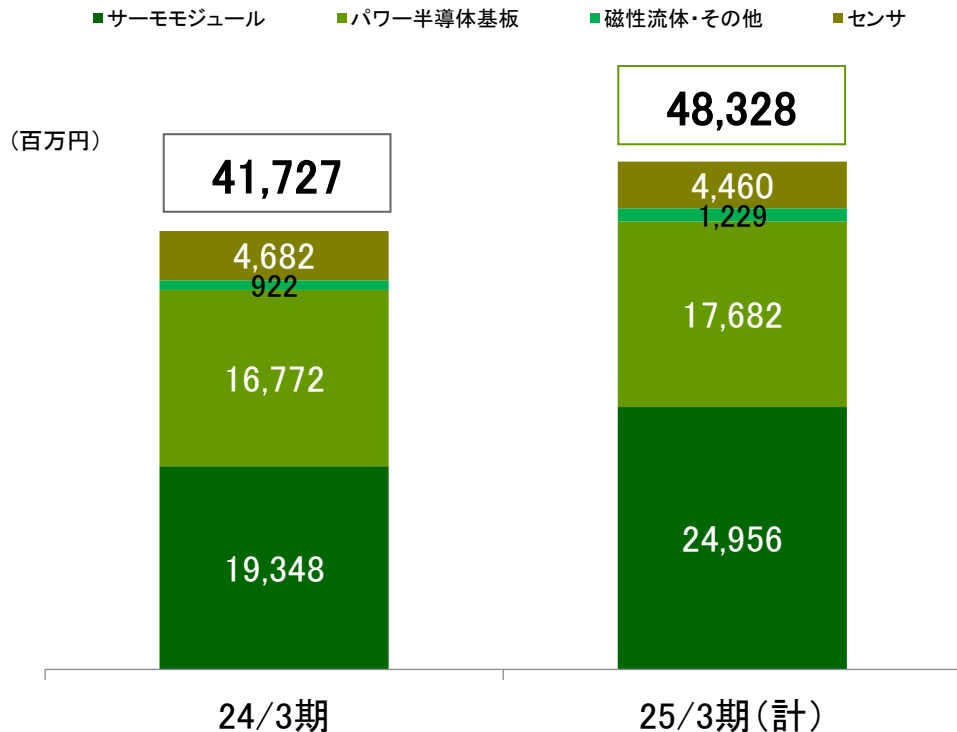
【半導体材料（石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC）】

- ・ 石英：火加工需要の取込み等により、前期比+14%見通し
- ・ シリコンパーツ：顧客在庫要因が継続、前期比減少
- ・ セラミックス：装置メーカー需要回復、新規品開拓により前期比+29%
- ・ CVD-SiC：岡山工場キャパ増、前期比+17%

【石英坩堝・洗浄事業】

- ・ 石英坩堝：PV向け需要が下期から急減、売上前期比+10%、採算悪化
- ・ 洗浄：半導体生産の回復から前期比+25%

売上高の推移



セグメント総括

- ・ サーモジュールの売上増加が牽引、パワー半導体基板は24/3下期の急進から調整局面となり減少、センサは決算期変更の影響から減少

製品別

【サーモジュール】

- ・ 生成AI関連需要が増加、前同+27%の増加

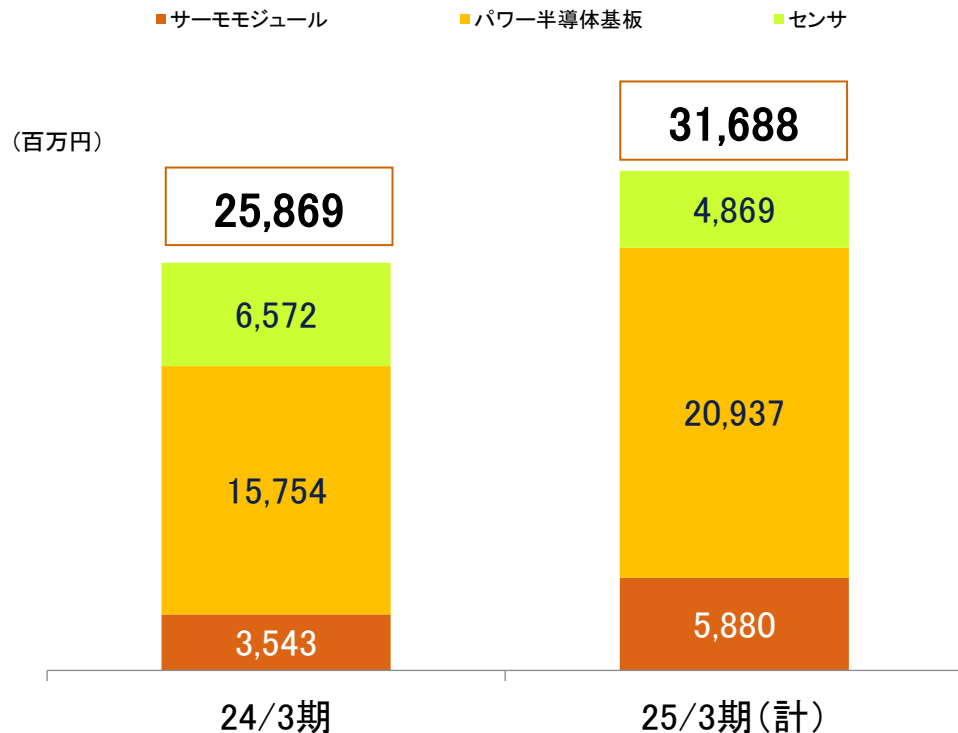
【パワー半導体基板】

- ・ 24/3下期の急増から一服、25/3期は前期比減少も、中期的な顧客需要は増加見通し

【センサー】

- ・ 決算期変更のため売上減少予想、営業活動強化を推進

売上高の推移



セグメント総括

- 自動車向けサーモモジュール及びパワー半導体基板は増加を予想、センサは決算期変更の影響から減少

製品別

【サーモモジュール】

- 自動車向け需要を開拓、前期比大幅増

【パワー半導体基板】

- 自動車向けAMB基板の増加が貢献、前期比増加

【センサー】

- 決算期変更の影響から25/3期は4月から12月の9か月間を反映、前期比減少

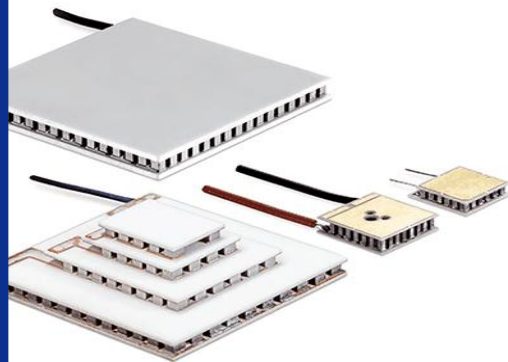
ご参考-25/3期 上期実績と下期計画値-業績別

(百万円)	2025年3月期上期 実績		2025年3月期下期 計画			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
売 上 高	135,157	100.0	129,847	100.0	△ 5,310	△ 3.9
売 上 総 利 益	38,111	28.2	34,794	26.8	△ 3,317	△ 8.7
販 売 管 理 費	23,859	17.7	23,046	17.7	△ 813	△ 3.4
営 業 利 益	14,251	10.5	11,749	9.0	△ 2,502	△ 17.6
経 常 利 益	15,470	11.4	10,530	8.1	△ 4,940	△ 31.9
当 期 純 利 益	9,190	6.8	6,810	5.2	△ 2,380	△ 25.9

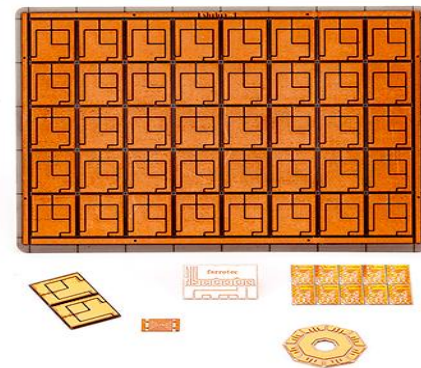
※数値については一部丸め処理を行ったものを記載

ご参考- 25/3期 上期実績と下期計画値-製品別

(百万円)	24/3期 実績			25/3期 実績及び予想					
	通期	上期	下期	通期(予想)	前期比	上期(実績)	前年同期比	下期(予想)	前年同期比
半 導 体 等 装 置 関 連	130,072	60,257	69,815	160,602	23.5%	84,042	39.5%	76,559	9.7%
真空シール	25,242	11,730	13,512	38,289	51.7%	19,347	64.9%	18,942	40.2%
石英製品	28,242	11,584	16,658	32,062	13.5%	16,134	39.3%	15,928	△ 4.4%
シリコンパーツ	14,604	7,712	6,892	13,894	△ 4.9%	7,172	△ 7.0%	6,722	△ 2.5%
セラミックス	24,314	11,657	12,657	31,383	29.1%	15,448	32.5%	15,935	25.9%
CVD-SiC	6,836	2,999	3,837	8,010	17.2%	3,992	33.1%	4,018	4.7%
EBガン・LED蒸着装置	5,935	3,011	2,924	7,316	23.3%	4,076	35.4%	3,240	10.8%
ウエーハ加工(連結対象外)	129	43	86	11	△ 91.5%	11	△ 74.4%	0	-%
再生ウエーハ	1,780	753	1,027	2,636	48.1%	1,250	66.0%	1,386	35.0%
部品洗浄	11,719	5,424	6,295	14,597	24.6%	7,061	30.2%	7,536	19.7%
石英坩堝	11,268	5,341	5,927	12,404	10.1%	9,547	78.7%	2,857	△ 51.8%
電 子 デ バ イ ス	41,727	18,834	22,894	48,328	15.8%	23,085	22.6%	25,242	10.3%
サーモモジュール	19,348	8,844	10,504	24,956	29.0%	12,431	40.6%	12,525	19.2%
パワー半導体基板	16,772	7,245	9,528	17,682	5.4%	8,692	20.0%	8,990	△ 5.6%
磁性流体・その他	922	398	524	1,229	33.3%	575	44.5%	654	24.8%
センサ	4,682	2,344	2,338	4,460	△ 4.7%	1,387	△ 40.8%	3,073	31.4%
車 載 関 連	25,869	14,006	11,865	31,688	22.5%	14,304	2.1%	17,383	46.5%
サーモモジュール	3,543	1,795	1,748	5,880	66.0%	3,108	73.1%	2,772	58.6%
パワー半導体基板	15,754	8,857	6,897	20,937	32.9%	9,628	8.7%	11,309	64.0%
センサ	6,572	3,352	3,220	4,869	△ 25.9%	1,567	△ 53.3%	3,302	2.5%
そ の 他	24,757	12,396	12,361	24,381	△ 1.5%	13,723	10.7%	10,658	△ 13.8%
合 計	222,430	105,494	116,936	265,000	19.1%	135,157	28.1%	129,842	11.0%



FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



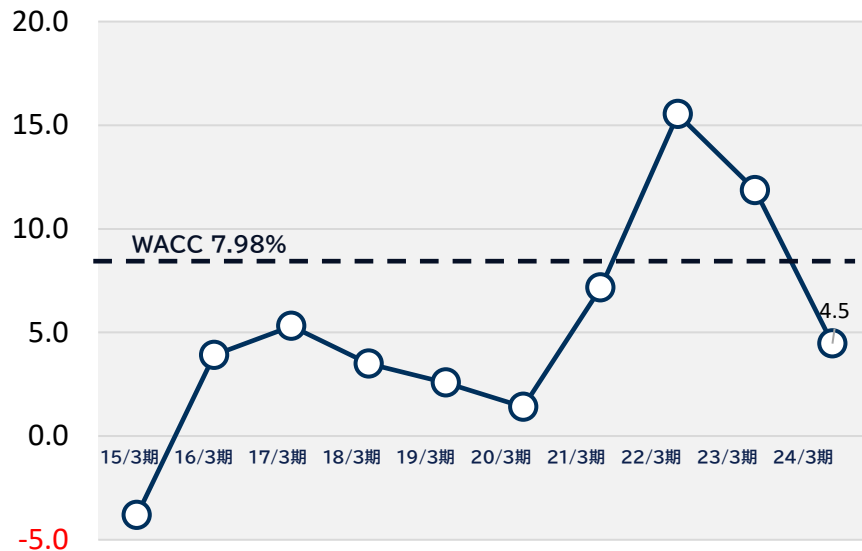
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組みと
株主還元策の強化



資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組み

- ・ 本年7月末に算出した当社の資本コストは8.62%。前期末ROEはこれを下回り、かつPBRは1倍割れの状況
- ・ ROE15%の中期目標に早期に近づけることで、資本コストを超過した企業価値の早期実現を目指す

ROICの推移(直近10期、単位%)



ROIC=親会社株主に帰属する当期純利益 / (有利子負債 + 自己資本)

注: EVA は企業の経済付加価値。EVAスプレッド(ROIC WACC)が>0であれば経済的な付加価値を見出していると言える。

加重平均資本コスト(WACC)

株主資本 比率	株主資本 コスト	負債比率	負債コスト (税引き後)	加重平均 資本コスト
総資産比 株主資本比率		総資産比 有利子負債 比率	借入金利× (1-実効税率)	
上場類似会社 15社の中央値 を採用	× 8.62% (24/3期)	上場類似会社 15社の中央値 を採用	×	= 7.98% (24/3期)
93.6%		6.40%	JCR格付BBB 8年社債の税引 後利回りを採用 1.069%	

現状評価と改善に向けた方針

現状評価

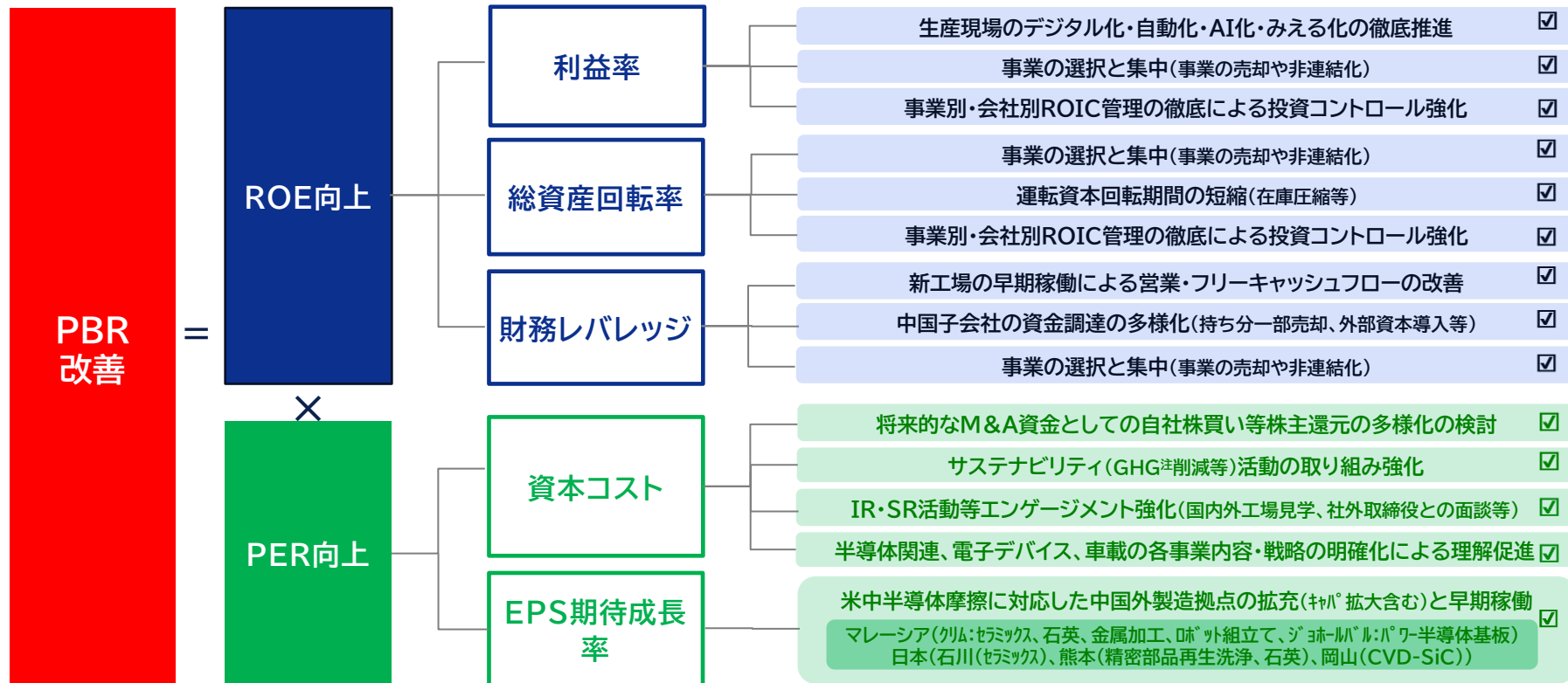
- ・ 24/3期は4.5%とWACC(24/3期7.8%)を大きく下回っており、EVAスプレッドはマイナスの状況。
- ・ 10期間のトレンドで見ても、WACCを超えた期は、2期(22/3期、23/3期)のみであり、ROICの改善が喫緊の経営課題と認識。

改善に向けた方針

- ・ 事業別、子会社別のROIC管理の徹底、ROICを基準とした投資判断・投資管理の更なる強化を図る。
- ・ 事業ポートフォリオの見直し・事業の選択と集中、グループ組織再編(事業売却や持ち分一部売却、非連結化等)によりROICの向上を図る。
- ・ 以上の施策により、事業成長のための投資を実行しながら、ROICを向上させる。27/3期ROIC8.0%を目指す。(中期経営計画KPI)

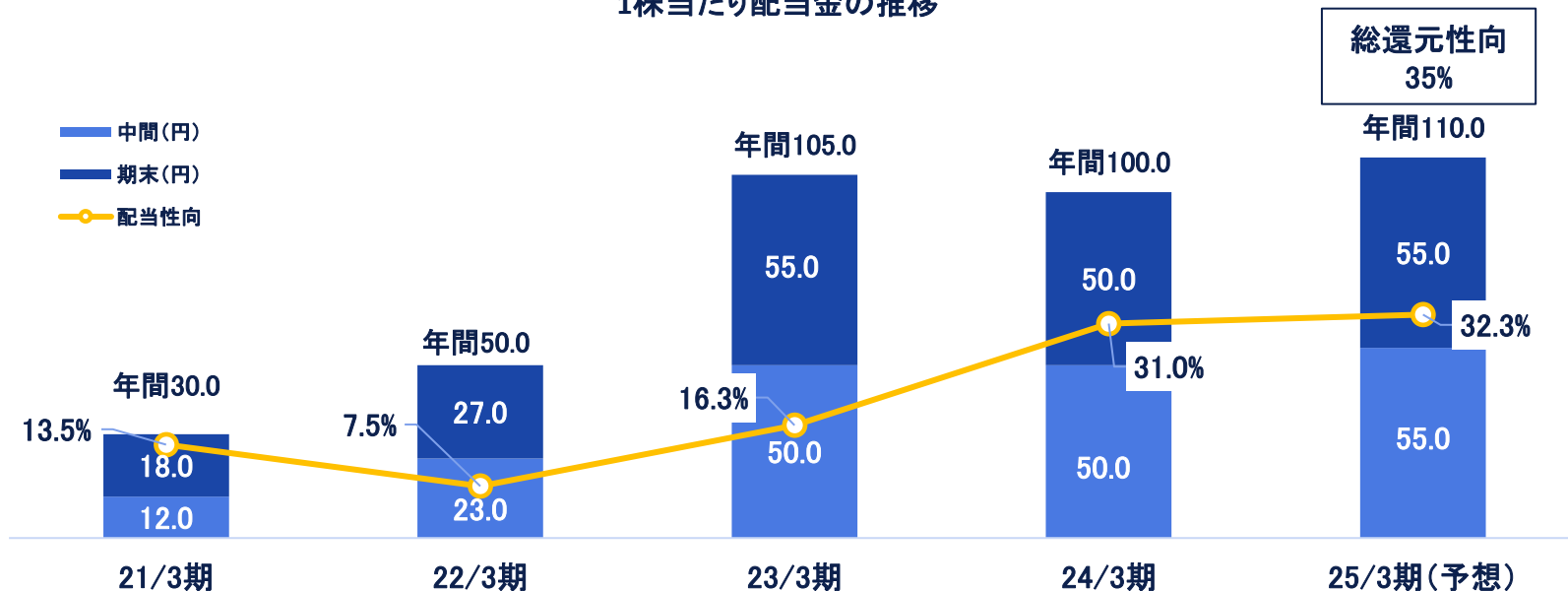
PBR改善に向けた取り組み

- 以下の施策実行によりROEの改善、PERの向上を図ることでPBR改善を目指す



- ①年間配当予想を1株当たり100円⇒110円へ増加、②自社株買い5億円を決定した
- 株主還元方針を見直し、「株主還元増加を重視、持続的な収益増強による配当の増加を目指しながら、自社株買いも機動的に活用、総還元性向30%を意識して、利益還元を図っていく」

1株当たり配当金の推移





中期経営計画 (24/5/31発表分)

事業成長

- ・ 半導体、自動車関連の事業成長を追求し、業界上位の事業を拡大させる
- ・ マレーシア、日本工場が中国外製造品の需要を取込み、中国工場が中国製造品の需要を取込む体制を強化する

生産効率・ 競争力の強化

- ・ 当社の量産能力を更に高めるため、デジタル化・自動化等を進め、工場の生産効率向上・競争力強化を追求する
- ・ 「品質は命」と考え品質管理の徹底を継続、研究開発体制を強化、新製品・新技術の開発を推進する

人材強化・ 企業文化

- ・ 人材重視を重要な経営戦略と位置付け、高度人材の採用、研修制度の拡充、株式報酬制度(RSU・PSU)導入を進める
- ・ 企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」を活動指針に掲げ、浸透を進める

財務・ 株主還元

- ・ 新增設工場の早期立上げ・業績貢献により、収益増強を図る
- ・ 株主還元増加を重視、配当性向は20%～30%を意識、株主還元の拡充に努める

中期経営計画KPI

(金額の単位は百万円)	24/3期(実)	25/3期(予)	26/3期(計)	27/3期(計)
売上高	222,430	265,000	300,000	380,000
営業利益	24,872	26,000	40,000	60,000
営業利益率	11.2%	9.8%	13.3%	15.8%
当期純利益	15,154	16,000	22,000	30,000
ROE	7.7%	→ 15%		
ROIC*	4.4%	→ 8%		
自己資本比率	40%	40%		
設備投資額	75,227	60,000	40,000	40,000
1株当たり配当金(年間)	100.0円	110.0円	財務・投資機会の状況を考慮 配当性向 <u>20%～30%</u> を意識、拡充に努める	

*ROIC = 親会社帰属純利益/(有利子負債+純資産) 純資産は新株予約権、非支配株主持分除く

- 上場部品洗浄子会社によるパワー半導体用基板子会社株式取得を計画

事業	部品洗浄	パワー半導体用基板	石英坩堝・シリコンパーツ	シリコンウエーハ（持分法）
会社名	安徽富楽徳科技発展股份有限公司	江蘇富楽華半導体科技股份有限公司	寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司	杭州中欣晶圆半導体股份有限公司
略称	FTSVA	FLH(旧FTSJ)	FTNC	CCMC
現在の出資比率	50.23%*	55.10%*	60.13%	23.05%
上場市場	深セン・創業板	上海・科創板	深セン・主板	上海・科創板
上場アドバイザー	—	—	東方証券承销保荐	—
直近評価額**	3,948億円（11/6付時価総額）	1,576億円	1,134億円	3,089億円
新株発行予定比率	—	—	25%	10%以上
進捗・目標スケジュール	上場アドバイザー登録	—	2021/11/4	—
	上場申請提出	—	2023/6/30	2024年
	上場審査合格	—	—	6月30日
	上場正式承認	—	—	申請取下げ
	上場予定日（目標）	—	2025年（目）	—

*FTSVA及びFLHの出資比率は今後変わる可能性があります。また両社の統合は中国証券当局の許可等が必要であり、未だ決定ではありません。

**評価額はFTSVA以外は2021年以降の第三者割当増資時に算定した株価で計算、中国元＝20.46円（2024/9/30TTM）

Copyright © Ferrotec Holdings Corporation. All Rights Reserved.

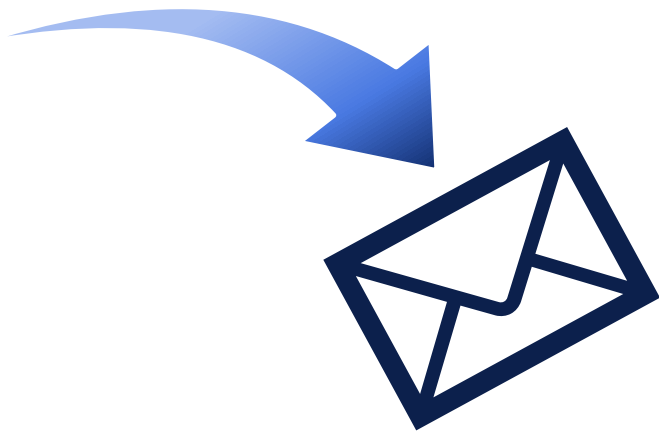
長期目標は売上高5,000億円・当期純利益500億円

長期業績目標は継続も、キャッシュフロー及びROE・ROIC向上を図りながら実現を図る

2030年度に売上高**5,000**億円 当期純利益**500**億円の達成を目指す！



IRポータルサイト「IRSTREET」にて、
当社のIRニュースを日英にて掲載・メールにて配信しております
ぜひ以下のURLよりご登録ください



■ 日本語でのご登録

[https://ircms.irstreet.com/member_registration/new_u.php?site=1&language=1&brand_selection=0®ist_brand_select\[\]=85](https://ircms.irstreet.com/member_registration/new_u.php?site=1&language=1&brand_selection=0®ist_brand_select[]=85)

■ 英語でのご登録

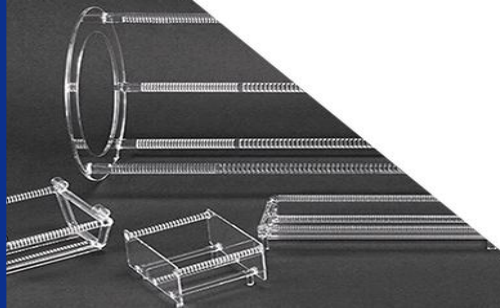
[https://ircms.irstreet.com/member_registration/new_u.php?site=2&language=2&brand_selection=0®ist_brand_select\[\]=85](https://ircms.irstreet.com/member_registration/new_u.php?site=2&language=2&brand_selection=0®ist_brand_select[]=85)



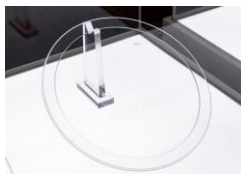
FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



Appendix



半導体製造装置向け治具・消耗材(当社主力のマテリアル製品群)



石英



シリコンパーツ



セラミックス



CVD-SiC

当社製品群の強み: 設備投資連動型(真空シール)のみでなく、**半導体デバイスメーカーの生産稼働連動型リピート消耗材(マテリアル製品)**、サービス(洗浄・再生ウェーハ)をラインアップ



真空シール

※半導体・FPD
製造装置部品



金属精密加工

※今後の中国国内顧客
(工場)増で伸長の見通し



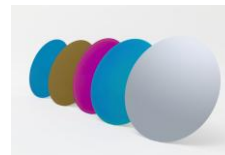
装置部品洗浄

※中国に加え、
日本に工場建設中



石英坩堝

※半導体・太陽電池向け



再生ウェーハ

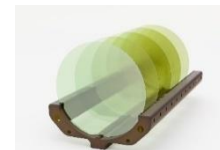
※中国市場に特化

持分法適用関連会社での事業



シリコンウェーハ

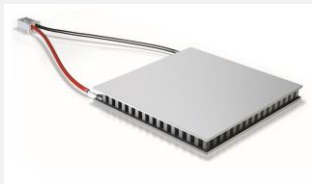
※月産能力6インチ 42万枚、8インチ 45万枚
12インチ25万枚



SiCウェーハ

※開発～量産化
(22/3期～新規事業))

サーモモジュール *



※自動車・半導体製造装置・通信・医療バイオ・民生品など、温度調整デバイスとして用途が拡大中



チラー

チラー(恒温水循環装置)は、水などの循環する液体を予め設定した温度に冷却/加熱しながら供給する装置。設備や装置にある熱源などの対象物を一定の温度に保つことに用いられる

パワー半導体用絶縁基板 *



※世界の消費電力削減のトレンドに対応し、パワー半導体顧客からの需要が拡大中(アルミナセラミックス基板に銅回路を接合する DIRECT COPPER BONDING技術)

パワー半導体のアプリケーション



磁性流体



※自動車スピーカーや、高音質TVスピーカー、スマホのバイブレーション向けへの用途が拡大中

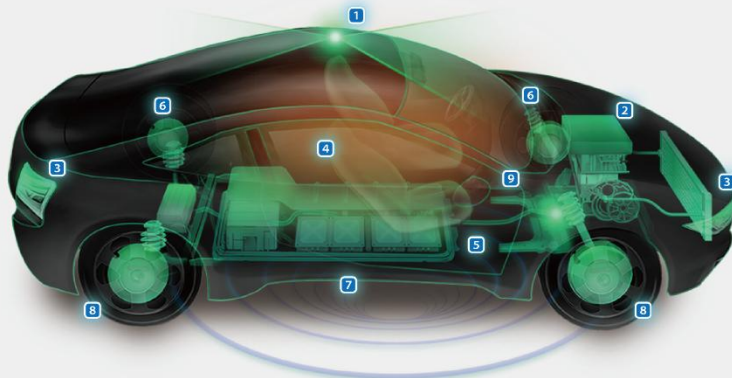
温度センサ(サーミスタ) *



※サーミスタは温度変化に対し、極めて大きな抵抗変化を示す半導体セラミックス。車載・家電・光通信などの温度センサとして幅広く使用され、車両電動化やデジタル化で需要拡大中

車載関連事業

電子デバイス製品の重要なターゲットとして、EV、PHV、自動運転システム等、アプリケーションの大きな変化が見込まれる自動車市場向けにもコア技術のサーモモジュール(ペルチェ素子)磁性流体、パワー半導体用基板などの導入を進めていきます。



サーモモジュール・アプリケーション

- 1 レーザーレーダー
- 2 バッテリークーリング
- 3 レーザーヘッドライト
- 4 シートクーリングシステム
- 9 ADAS GPU CPU CMOS GPUクーラー CMOSクーラー
- 10 ステアリングヒーター・クーラー
- 11 カップホルダー
- 12 HUD(ヘッドアップディスプレイ)

磁性流体・アプリケーション

- 2 エンジンサスペンション
- 4 シートサスペンション
- 6 足周りサスペンション
- 7 SOC監視用Hzero®高精度直流測定センサー
- 8 Hzero® コンボジットホイールインモーター
- 13 タッチパネル
- 14 スピーカー



クーラーボックス

パワー半導体用基板・アプリケーション

- 2 エンジンエンジン制御
- 3 ボディーヘッドランプ制御 ルームランプ制御
- 5 パワートレイン HEVモータ制御 ブレーキ制御 トランスミッション制御 ステアリング制御



カップホルダー

- 本資料に掲載されている将来見通しの記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額及び市況、為替レートなどが含まれますが、これに限定されるものではありません。
- 本資料中の定量目標などは、あくまで中長期的な戦略、ビジョン等を示すものであり業績予想ではありません。当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。

＜本件照会先＞

広報部 03-3281-8186